

低温固化系列导电银浆——电脑大键盘线路用

导电银浆 BY-2200

产品简介：BY-2200 导电银浆是上海宝银电子材料有限公司（BEMC）生产的一种低阻抗快干型纯银浆。它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成，适用于丝网印刷。

典型应用：本品是专为电脑键盘线路研发的，同样适用于其他柔性印刷电路。

通用特点：有着良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度和极强的附着力。



技术指标：

物理性能指标	测试方法	测试标准
外观	肉眼观察	浅灰色胶体
填料		银
气味		轻微
粘度（Pa.S）	NDJ-7 旋转式粘度计，II 转子，75rpm,25℃	10-20
细度（ μm ）	刮板细度计	<10
固含量（wr%）		$65\pm 2\%$
涂布面积（ cm^2/g ）	取决于膜层厚度板	100-200
固化后性能指标	测试方法	测试标准
浆料方阻（ $\text{m}\Omega/\square$ ）	万用表	10-12
附着力	3M810 胶带，垂直拉	无脱落
硬度（H）	中华铅笔	≥ 2
工作温度（℃）	线路温度	<70
电阻（ Ω ）	干膜厚 $5\mu\text{m}\pm 1\mu\text{m}$ 、键盘回路电阻	$600\leq R\leq 800$
挠曲性（ Ω ）	线宽 1mm，2 公斤力 $\times 180^\circ$ 外折 $\times 1$ 分钟 $\times 3$ 次	$\Delta R/R$ 小于 300%

使用说明及指引：

基材：在 PET 和 PC 等片材上均可使用。

搅拌：使用前彻底搅拌均匀。

稀释：本品搅拌均匀后即可使用，建议不加稀释剂。如需稀释，需使用专用稀释剂 X-2200 稀释，建议按小于银浆重量比例的 3% 进行稀释，稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准，产品质量和性能不予保证。

印刷：本品在 PET 和 PC 等片材上均可使用，固化后的膜厚和最终电阻受诸多因素影响，如网板大小、张力、刮胶硬度、角度和速度、感光浆厚度等。

推荐固化工艺：

厚度：干膜 4-6 μm

丝网：用 200-300 目聚酯丝网或不锈钢丝网

IR 烘道：150℃ $\times$ 1.5 分钟

蜗牛炉：150℃ $\times$ 6 分钟

储存条件及保质期：

密封保存于干燥阴凉处，贮存温度在 5-25℃；未开封罐装，保质期为 6 个月。